



## FQD1N60C / FQU1N60C

### 600V N-Channel MOSFET

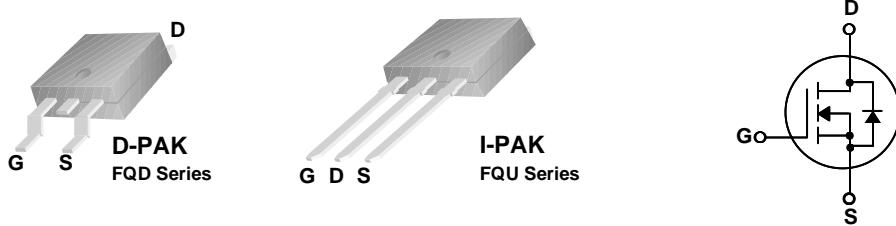
#### General Description

These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Corise Semiconductor's proprietary, planar stripe, DMOS technology.

This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supply.

#### Features

- 1A, 600V,  $R_{DS(on)} = 11.5\Omega @ V_{GS} = 10\text{ V}$
- Low gate charge ( typical 4.8nC)
- Low Crss ( typical 3.5 pF)
- Fast switching
- 100% avalanche tested
- Improved dv/dt capability



#### Absolute Maximum Ratings

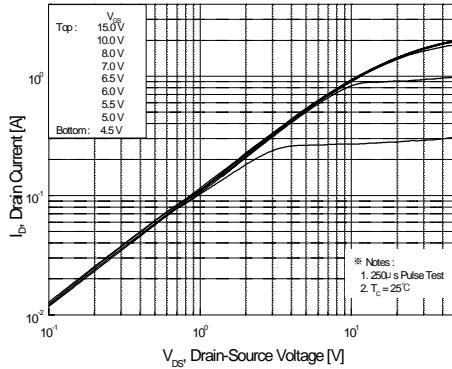
$T_C = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted

Symbol	Parameter	FQD1N60C / FQU1N60C	Units
$V_{DSS}$	Drain-Source Voltage	600	V
$I_D$	Drain Current - Continuous ( $T_C = 25^\circ\text{C}$ )	1	A
	- Continuous ( $T_C = 100^\circ\text{C}$ )	0.6	A
$I_{DM}$	Drain Current - Pulsed	(Note 1)	A
$V_{GSS}$	Gate-Source Voltage	$\pm 30$	V
$E_{AS}$	Single Pulsed Avalanche Energy	(Note 2)	mJ
$I_{AR}$	Avalanche Current	(Note 1)	A
$E_{AR}$	Repetitive Avalanche Energy	(Note 1)	mJ
$dv/dt$	Peak Diode Recovery $dv/dt$	(Note 3)	V/ns
$P_D$	Power Dissipation ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )*	2.5	W
	Power Dissipation ( $T_C = 25^\circ\text{C}$ )	28	W
	- Derate above $25^\circ\text{C}$	0.22	W/ $^\circ\text{C}$
$T_J, T_{STG}$	Operating and Storage Temperature Range	-55 to +150	$^\circ\text{C}$
$T_L$	Maximum lead temperature for soldering purposes, 1/8" from case for 5 seconds	300	$^\circ\text{C}$

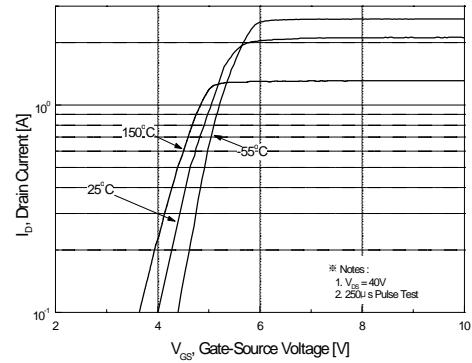
#### Thermal Characteristics

Symbol	Parameter	Typ	Max	Units
$R_{\theta JC}$	Thermal Resistance, Junction-to-Case	--	4.53	$^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction-to-Ambient*	--	50	$^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	--	110	$^\circ\text{C}/\text{W}$

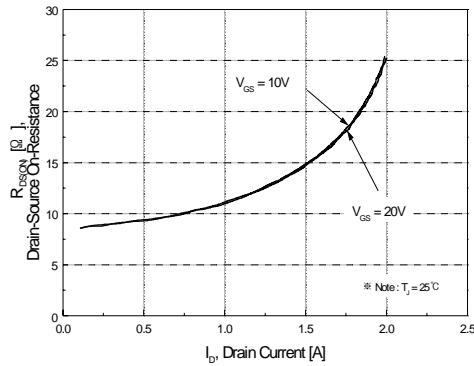
Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
<b>Off Characteristics</b>						
BV <sub>DSS</sub>	Drain-Source Breakdown Voltage	V <sub>GS</sub> = 0 V, I <sub>D</sub> = 250 µA	600	--	--	V
ΔBV <sub>DSS</sub> / ΔT <sub>J</sub>	Breakdown Voltage Temperature Coefficient	I <sub>D</sub> = 250 µA, Referenced to 25°C	--	0.6	--	V/°C
I <sub>DSS</sub>	Zero Gate Voltage Drain Current	V <sub>DS</sub> = 600 V, V <sub>GS</sub> = 0 V	--	--	1	µA
		V <sub>DS</sub> = 480 V, T <sub>C</sub> = 125°C	--	--	10	µA
I <sub>GSSF</sub>	Gate-Body Leakage Current, Forward	V <sub>GS</sub> = 30 V, V <sub>DS</sub> = 0 V	--	--	100	nA
I <sub>GSSR</sub>	Gate-Body Leakage Current, Reverse	V <sub>GS</sub> = -30 V, V <sub>DS</sub> = 0 V	--	--	-100	nA
<b>On Characteristics</b>						
V <sub>GS(th)</sub>	Gate Threshold Voltage	V <sub>DS</sub> = V <sub>GS</sub> , I <sub>D</sub> = 250 µA	2.0	--	4.0	V
R <sub>DS(on)</sub>	Static Drain-Source On-Resistance	V <sub>GS</sub> = 10 V, I <sub>D</sub> = 0.5 A	--	9.3	11.5	Ω
g <sub>FS</sub>	Forward Transconductance	V <sub>DS</sub> = 40 V, I <sub>D</sub> = 0.5 A (Note 4)	--	0.75	--	S
<b>Dynamic Characteristics</b>						
C <sub>iss</sub>	Input Capacitance	V <sub>DS</sub> = 25 V, V <sub>GS</sub> = 0 V, f = 1.0 MHz	--	130	170	pF
C <sub>oss</sub>	Output Capacitance		--	19	25	pF
C <sub>rss</sub>	Reverse Transfer Capacitance		--	3.5	4.5	pF
<b>Switching Characteristics</b>						
t <sub>d(on)</sub>	Turn-On Delay Time	V <sub>DD</sub> = 300 V, I <sub>D</sub> = 1.1 A, R <sub>G</sub> = 25 Ω	--	7	24	ns
t <sub>r</sub>	Turn-On Rise Time		--	21	52	ns
t <sub>d(off)</sub>	Turn-Off Delay Time		--	13	36	ns
t <sub>f</sub>	Turn-Off Fall Time		--	27	64	ns
Q <sub>g</sub>	Total Gate Charge	V <sub>DS</sub> = 480 V, I <sub>D</sub> = 1.1 A, V <sub>GS</sub> = 10 V	--	4.8	6.2	nC
Q <sub>gs</sub>	Gate-Source Charge		--	0.7	--	nC
Q <sub>gd</sub>	Gate-Drain Charge		--	2.7	--	nC
<b>Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings</b>						
I <sub>S</sub>	Maximum Continuous Drain-Source Diode Forward Current	--	--	1	--	A
I <sub>SM</sub>	Maximum Pulsed Drain-Source Diode Forward Current	--	--	4	--	A
V <sub>SD</sub>	Drain-Source Diode Forward Voltage	V <sub>GS</sub> = 0 V, I <sub>S</sub> = 0.5 A	--	--	1.4	V
t <sub>rr</sub>	Reverse Recovery Time	V <sub>GS</sub> = 0 V, I <sub>S</sub> = 1.1 A, dI <sub>F</sub> / dt = 100 A/µs	--	190	--	ns
Q <sub>rr</sub>	Reverse Recovery Charge		--	0.53	--	µC
<b>Notes:</b>						
1.	Repetitive Rating : Pulse width limited by maximum junction temperature					
2.	L = 59 mH, I <sub>AS</sub> = 1.1 A, V <sub>DD</sub> = 50V, R <sub>G</sub> = 25 Ω, Starting T <sub>J</sub> = 25°C					
3.	I <sub>SD</sub> ≤ 1.1 A, dI/dt ≤ 200A/µs, V <sub>DD</sub> ≤ BV <sub>DSS</sub> , Starting T <sub>J</sub> = 25°C					
4.	Pulse Test : Pulse width ≤ 300µs, Duty cycle ≤ 2%					
5.	Essentially independent of operating temperature					



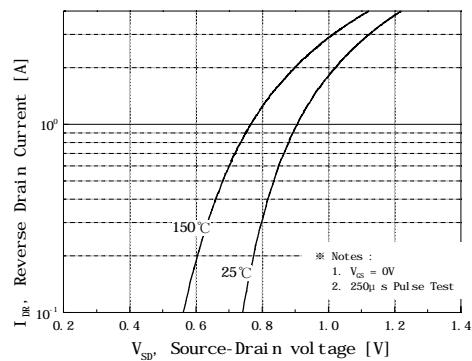
**Figure 1. On-Region Characteristics**



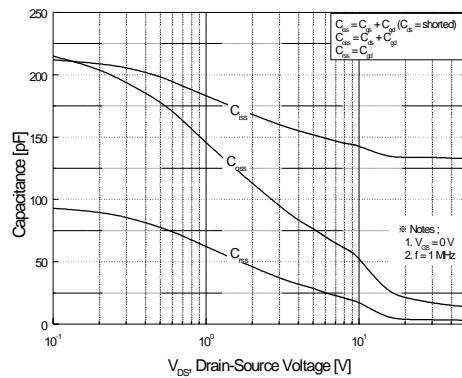
**Figure 2. Transfer Characteristics**



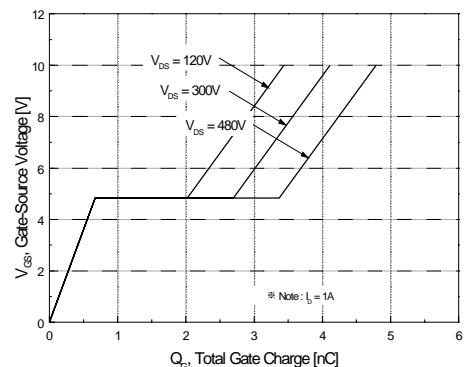
**Figure 3. On-Resistance Variation vs. Drain Current and Gate Voltage**



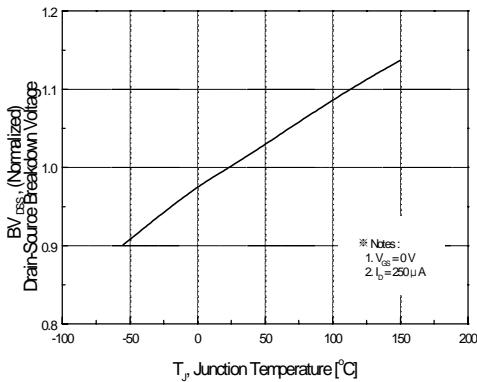
**Figure 4. Body Diode Forward Voltage Variation with Source Current and Temperature**



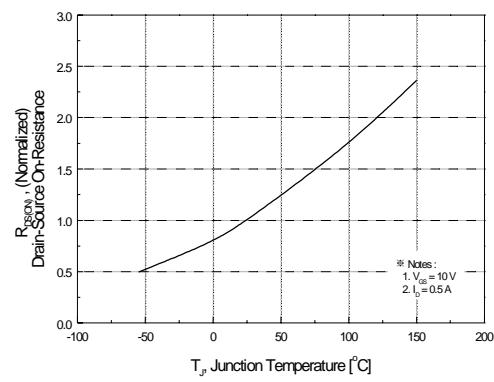
**Figure 5. Capacitance Characteristics**



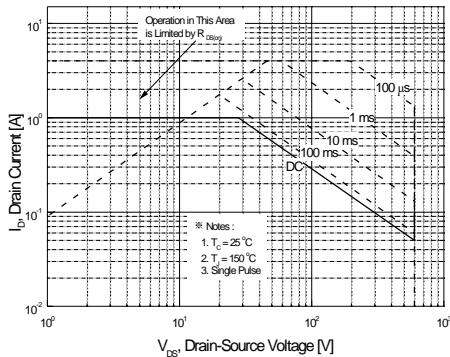
**Figure 6. Gate Charge Characteristics**



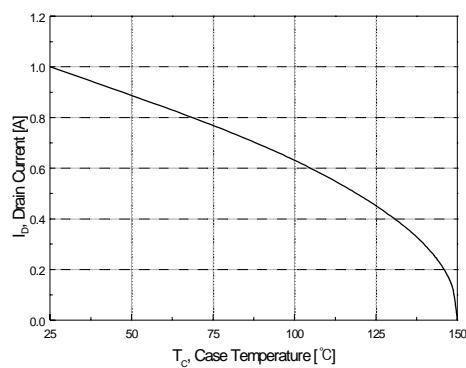
**Figure 7. Breakdown Voltage Variation  
vs Temperature**



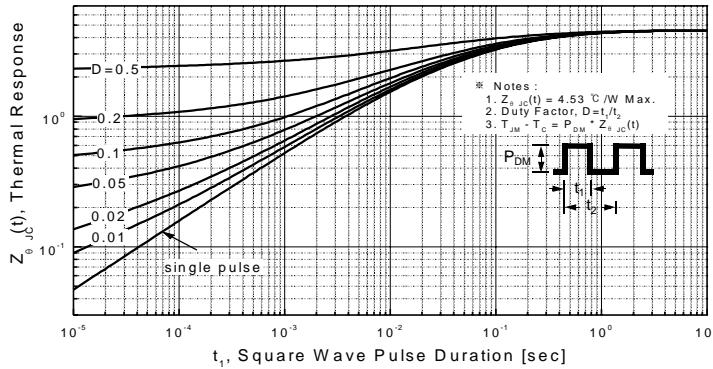
**Figure 8. On-Resistance Variation  
vs Temperature**



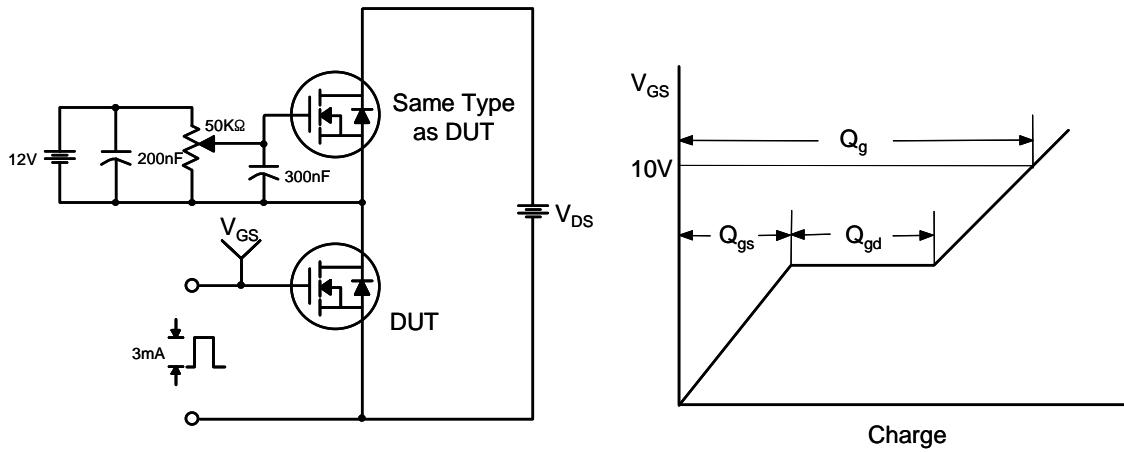
**Figure 9. Maximum Safe Operating Area**



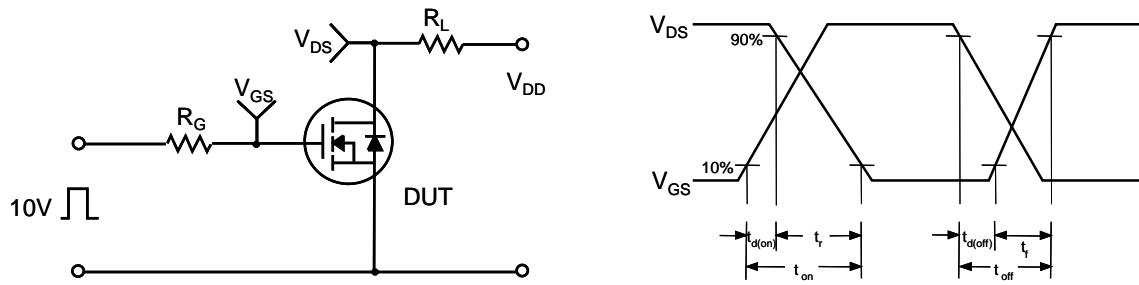
**Figure 10. Maximum Drain Current  
vs Case Temperature**



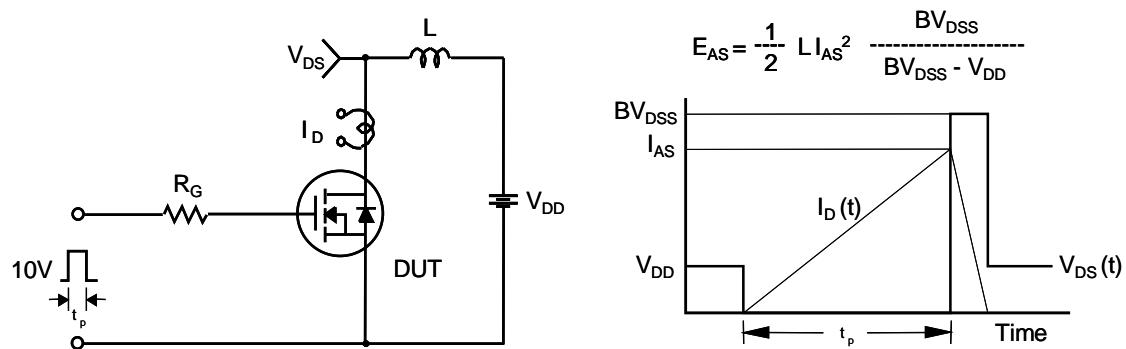
**Figure 11. Transient Thermal Response Curve**

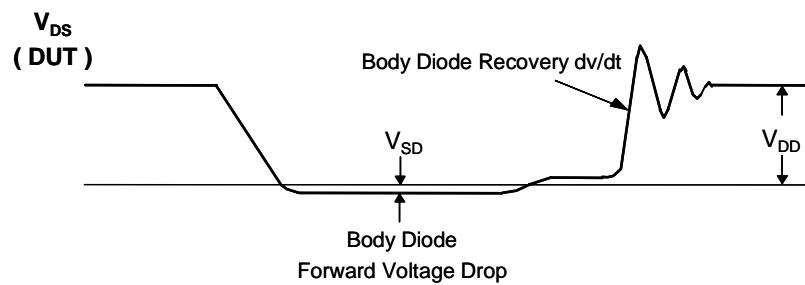
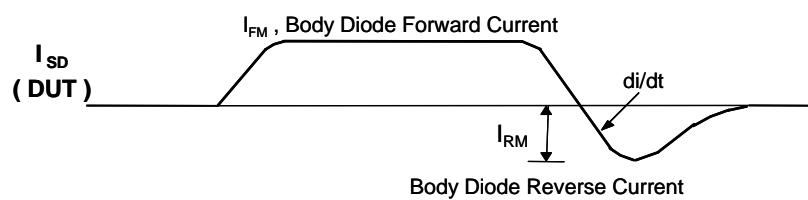
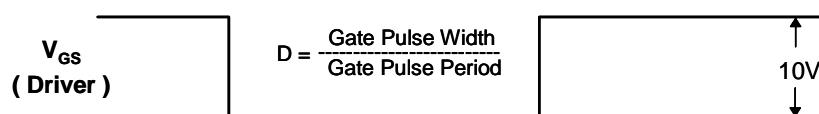
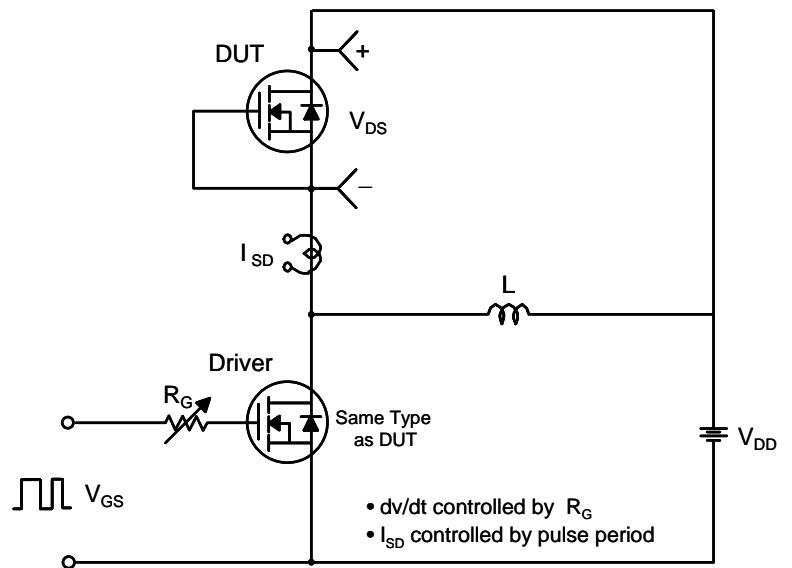


Resistive Switching Test Circuit & Waveforms



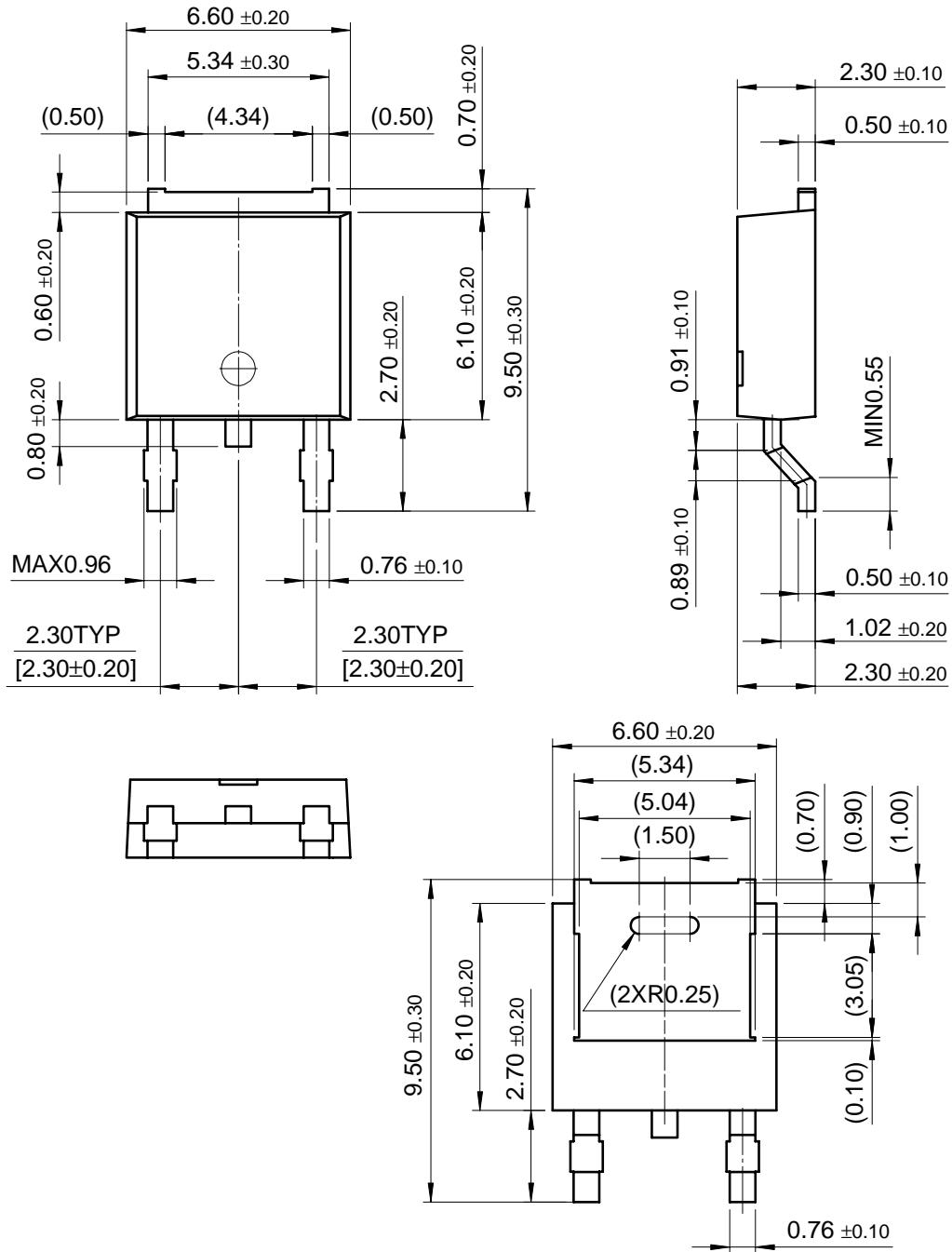
Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms





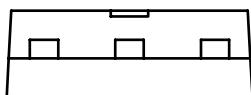
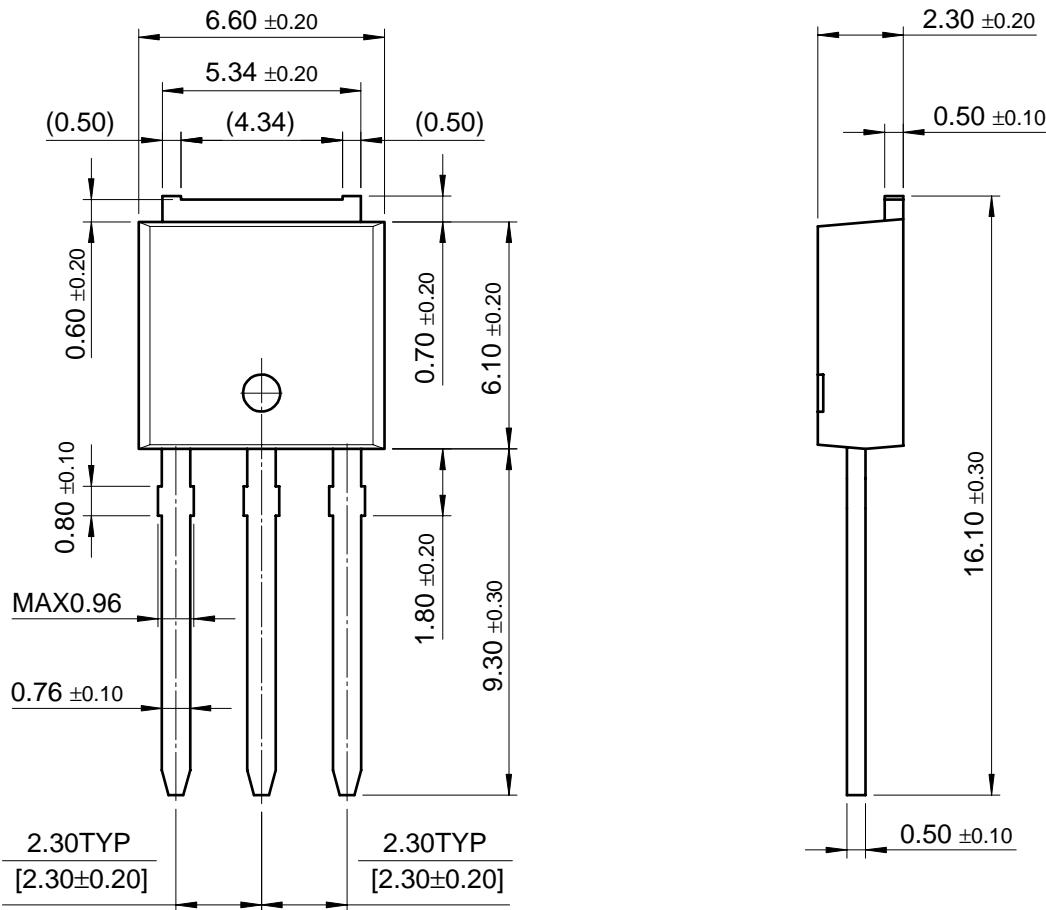
**FQD1N60C / FQU1N60C**

**D-PAK**



**FQD1N60C / FQU1N60C**

**I-PAK**





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,  
помещение 100-Н Офис 331